

卡片生产技术

产品手册





目录

纽约集团概览.....	4	
生产执行系统.....	6	
裱条带		
MAE 12	8	
片张热烫印		
SSH 2008/2.....	10	
ASH 10000.....	12	
薄膜冲切		
FP 201.....	14	
INLAY 生产与测试		
MTT 2462.....	16	
ITH 540 & IT 50	18	
ITH 550	20	
IAL 10000.....	22	
片张装订		
SSC 2502 & SSC 2502/1.....	24	
SSC 200.....	26	
SSC 2700	28	
ASC 2900	30	
ASC 3000	32	
片张层压		
LP 5570.....	34	
LP 5570 ecoLINE.....	36	
冲卡		
CP 202	38	
CP 2007/A & CP 2007/M	40	
CP 2021/A & CP 2021/M	42	
卡片检测		
CI 100	44	
CI 200	46	
CI 36050	48	
卡片热烫印		
CHS 6001	50	
质量检测		52
产品系列		53
笔记		54

纽约集团概览

纽约的业务与分布

1981年成立于德国巴伐利亚州的中心地带，纽约集团已发展为零件与系统、半导体相关产品、证件解决方案相关产品和TECURITY® 政府方案等领域的世界级供应商。纽约在全球拥有约3500名员工，在德国、马来西亚、中国、斯洛伐克、美国和塞尔维亚拥有技术中心及其他共计35个销售与服务中心，纽约已建立了强大的全球性生产服务网络。

我们持续投资最新技术和创新工艺，增强自身生产力，并为客户提供优化的解决方案。我们的精密零部件生产工厂MPS – Mühlbauer Parts & Systems – 确保了供货灵活性和极高的客户满意度。

我们的自动化业务部门不仅开发和组装个性化定制的生产系统，也为证件和解决方案相关产品的生产流程提供匹配的软件方案。纽约综合产品系列还包括视觉检测技术与半导体和RFID应用。

纽约TECURITY® 部门是实现证件和个人识别与验证安全系统的理想合作伙伴。在过去三十多年里，纽约在全球参与实现了300多个身份证件项目，这些丰富的项目经验让我们能够为客户带来更全面的服務。



纽约
波黑



纽约
中国



纽约
德国



纽约
马来西亚



纽约
塞尔维亚



纽约
斯洛伐克



纽约
美国





MPS
精密零件与表面处理工程



AUTOMATION
生产设备与系统



WORLD OF SECURITY®
政府与技术解决方案

生产执行系统



MB MCES

PERSONALIZATION MANAGEMENT

MB MCES是一个个人化管理软件，集成生产数据输入和相关的物理电气个人化控制。MB MCES可处理不同输入方式和格式的个人化数据。



MB INCAPE

INTEGRATED PRODUCTION MANAGEMENT SOFTWARE

MB INCAPE是纽约的生产管理软件，用于智能卡和证件（例如身份证、电子护照、驾照、EMV或GSM卡）的生产和个人化管理。结合数据管理、生产控制和材料管理，这个软件可以实现高自动化生产流程。它可以灵活地处理客户和特定应用的生产、个人化、质量控制和证件传递方案。



MB PALAMAX®

TOTAL PROCESS TRANSPARENCY

MB PALAMAX®, 纽约的智能工厂解决方案，开发用于卡片、标签或证照册的生产、个人化工厂和半导体后道生产车间。软件可以设置和收集工艺数据来监控和提升生产与个人化的效率，便于后续工艺处理、可视化和统计分析。



MB TOOL LEADER

CONNECTOR BETWEEN SYSTEMS

MB TOOL LEADER是包含了几种应用的软件包，可以可靠地连接生产流程相关的几个单独设备。整个工艺链条 - 从订单输入到最终精密零件生产 - 可以轻松地监控和控制这个流程。实时设备监控保证了自动化生产，可以及时探测到生产错误并在早期就解决问题。因此MB TOOL LEADER可以有效减少设备停机时间，将设备生产力提升约20%。



特点与优势



可以配置个性化、质量检测 and 证卡发行的工作步骤



无缝连接到MB PALAMAX®和纽约数据准备系统MB Data Preparation



全自动处理与生产管理



基于web的运营商客户端简化了管理流程



可扩展用于不同证件、设备和个人化地点



实时生产性能监控



完美结合纽约材料管理系统(MB WAREHOUSE)



无缝追踪证件从生产到发卡



通过网络服务、数据库、基于文件的接口连接到卡片/证件管理系统



统计工具分析收集到的数据并提供定制化的OEE统计信息



个人化设备的标准接口，提供集成第三方设备的可能性



在控制中心远程管理车间的设备



集成纽约用户管理系统MB User Management



提升有效性和效率，提高盈利



全面覆盖生产控制需求(安全工业与EMV 标准)



使生产工程师能够准备和测试重复性的工厂设置。工厂能在几分钟内切换产品

MAE 12

裱条带系统

MAE 12 是用于在片张上制作磁条/签名条或者安全性条带应用的高灵活性设备。这是一站式生产卡片和智能卡的附加处理步骤。在裱条带处理中，磁条被转印到表面覆膜上。一次可同时烫印达12个磁条。在12条轨道同时运行时，设备每小时可生产最高达72,000张卡(卷到卷或

者卷到张)。这是基于厚度为40-400 μm ，宽度780mm的面材。磁条是整条压到面材上的。MAE 12使条带完全粘附在面板材上实现面材操作安全和避免在层压时条带位置变化。MAE 12为适应不同条带宽度和间距而设计。直观的操作和易于维护的特点提高了生产效率。



主要模块



卷材输入



薄膜对齐



条带施放



热烫处理



卷材输出
(可选片张输出)



特点与技术参数

主要特点

- 签名条和磁条自动裱糊系统，可应用于银行卡，证件卡，会员卡等
- 片张尺寸，条带材料，位置和轨道数量可灵活调整
- 特别针对大规模量产的成本优化解决方案
- 以边缘为参考的传感器校准控制系统
- 可以接入MB INCAPE系统

生产/工艺模块

- 卷到卷或卷到张生产方式（可以修改）
- 集成不同材质的条带绕卷系统
- 速度和温度可持续调整
- 人性化操作和轨道位置快速调整
- 实现高自动化生产的材料缓冲
- 可用率: 高达95%
- 良率: 高达 99.7%

技术参数

- 片张材料: PVC, PC, ABS; 客户需求的其他材料
- 片张厚度: 40 – 400 μm
- 覆膜层最大宽度: 780 mm
- 最大卷轴直径: 750 mm
- 输出叠放高度: 200 mm
- 压力/温度: 30 – 55 N / 最高 200°C
- 条带最大宽度: 最小 6 mm 至最大 16 mm
- 轨道数量: 最多 12个
- 精度: Y轴 +/- 0.15 mm
- 轨道间距: ≥ 57 mm
- 片张切割精度: +/- 0.5 mm
- 速度: 最大 10 m / min (12-fold版式)
- 产能: 72,000张卡/时

裱条带 

片张热烫印 

薄膜冲切 

INLAY 生产与测试 

片张装订 

片张层压 

冲卡 

卡片检测 

卡片热烫印 

UPH

40000 50000 60000 70000 80000 90000



SSH 2008/2




片张热烫印

SSH 2008/2 是纽约第二代半自动片张热烫印设备。DOVIDs 例如全息图和其他热激活特征可烫印到塑料片张上。设备可将全息图烫印到最终产品的表面或单一片张

层上然后层压到最终片张中。所以全息图可以隐藏在材料结构中作为一项防伪安全要素。SSH 2008/2 适用于防伪证件例如身份证或护照的嵌入式全息图生产。



主要模块

-  x/y 片张台面
-  热烫印模块 (1 个烫印头)
-  DOVID 应用



特点与技术参数

主要特点

- 半自动片张热烫印设备适合将全息图或KINEGRAMs® 烫印到覆膜层或中心层
- 设备可在很短时间内匹配不同产品和布局
- 所有必要的参数 (温度、压力和时间) 都可以根据不同的材料设置
- 覆膜层下高安全防伪因素全息图/ KINEGRAM®
- 高度灵活用于不同应用和定制化需求例如视觉、条码读取或OCR
- 高精度全息图/KINEGRAM® 应用
- 人性化操作系统
- 可调节可储存的工艺参数确保设备灵活性
- 在全息图 / KINEGRAM®和卡片布局之间没有偏移


生产/工艺模块

- 将片张从装载位置按顺序移动到所有应用操作位置的真空台,根据边缘标记对齐片张,真空夹
- 通过卷轴将条带输入和放置到烫印头下
- 烫印位置处有特殊的传感器用于全息图的打印标定
- 气动驱动结构, 可以调节压力、烫印温度和停留时间
- 特殊的薄膜剥离器可以完整剥离全息标, 保证没有锯齿碎片的锐利边缘
- 简单标准几何图形烫印工具(圆形, 圆角矩形, 椭圆形), 用于客户定制的尺寸或特殊几何形状(选配)
- DOVID 全息标条带在绕卷前销毁(带分切全息图膜的刀具)

技术参数


- 片张尺寸: 最大630 x 630 mm
- DOVID 条带宽度: 最大 45 mm
- 中心直径: 1" or 3"
- 卷轴直径: 最大 120 mm
- 烫印尺寸: 最大 \varnothing 20 mm
- 热烫印压力: 最大 3 kN
- 定位精度: \pm 0.1 mm
- 热烫印温度: 20 - 170° C

裱条带 

片张热烫印 

薄膜冲切 

INLAY 生产与测试 

片张装订 

片张层压 

冲卡 

卡片检测 

卡片热烫印 

UPH



ASH 10000

片张热烫印

纽约的 ASH 10000 是用于全息标识和安全要素薄膜在塑料片张特定位置热烫印的设备。这些全息标识主要烫印在覆膜层背面或烫印在中心打印层上。

两种烫印方式都可以实现卡内结构的全息标识，不论薄膜是覆膜层还是中心层材料。这台设备主要应用于 ID-1 格式和PC卡。



主要模块



放卷或片张输入



DOVID全息标应用



热烫印模块 (4-8 个烫印头)



清洁模块



视觉控制系统 (选配)



切割模块-卷到张



绕卷或片张输出



特点与技术参数

主要特点

- 全自动片张热烫印系统，可将全息标识和安全要素薄膜烫印到指定位置以及分放到烫印塑料片张上
- 全息标识 Hologram/ KINEGRAM® 烫印在覆膜层下形成高安全耐用的防伪要素（最高可达3级）
- 每个烫印头的温度和压力可以单独设置
- 利用压力和温度将全息标Hologram烫印到覆膜层

生产/工艺模块

- 卷轴输入材料 (卷到卷, 卷到张) 或片张输入形式 (张到张)
- 片张切割装置将卷材切割成张(卷到张)
- 片张对齐和平滑通过设备
- 将全息图从全息箔烫印到片张上
- 标准-4个热烫印头, 可选配最多8个热烫印头 (片张布局)
- 视觉系统检查工艺质量 (选配)
- 标记单元标记坏的全息图
- 错误片张被统一放置到废料盒
- 薄膜绕卷到输出膜卷轴 (卷到卷) 或片张堆叠到输出堆栈 (卷到卷, 张到张)

技术参数

卷轴输入(卷到张); 输出到卷(卷到卷);

- 卷材直径: 最大 500 mm
- 卷材宽度: 最大 630 mm
- 中心直径: 76 mm (3")
- 烫印温度: RT -170°C
- 产能: 最高10000 UPH

输入堆栈与对齐单元 (张到张):

- 最大片张堆叠高度: 700 mm
- 片张尺寸: 最小 270 mm x 194 mm
- 片张尺寸: 最大. 630 mm x 630 mm
- 片张材料: PVC, ABS, PC, 纸: ≥ 0.075 mm

全息图尺寸:


- 一般烫印工具尺寸: 最大 $\varnothing 20$ mm用于标准热烫印全息箔

裱条带 

片张热烫印 

薄膜冲切 

INLAY 生产与测试 

片张装订 

片张层压 

冲卡 

卡片检测 

卡片热烫印 

UPH



FP 201

薄膜冲切系统

纽约的FP 201是半自动塑料薄膜冲切设备。设备用于内层薄膜冲切，是用于非接卡、Hybrid卡和RFID票卡冲切的理想化、低成本设备。另外FP 201还可

用于电子封面inlay的窗口生产。设备可一次性冲切多张薄膜，小时产能可达300张。



主要模块



手动薄膜输入



自动废料输出



薄膜冲切



手动薄膜输出



特点与技术参数

主要特点

- 手动输入片张
- 高精度一次性冲切
- 手动片张输出
- 自主模具生产
- 特殊 / 定制化模具设计
- 快速自主模具打磨服务
- 可用于不同材料的可靠的冲切系统

生产/工艺模块

- 气动冲切系统 (直接驱动)
- 无需电源: 简易操作与维护
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%
- 对齐参考标

技术参数


- 片张材料: PVC, PC, ABS, PET; 客户需求的其他材料
- 片张尺寸最大: 350 mm x 500 mm
- 片张厚度: 50 μm - 300 μm
- 冲切驱动: 气动驱动 (气压 6 bar)
- 模具冲切精度: ± 0.02 mm
- 冲切位置精度: ± 0.1 mm
- 产能: 最高可达300张/时

裱条带 

片张热烫印 

薄膜冲切 

INLAY 生产与测试 

片张装订 

片张层压 

冲卡 

卡片检测 

卡片热烫印 

UPH

50

100

150

200

250

300

MTT 2462

天线绕制与RFID INLAY 生产系统

纽约的天线绕制与 RFID Inlay生产系统MTT将所有生产工艺集中到一个平台上：芯片冲切、芯片模块放置、超声波绕线、热压芯片焊接与电子光学检测及不良产品标记。MTT是一台强大成熟的设备，全球已售100台。可生

产任何电子护照和智能卡的RFID Inlay：不论是ID-1或ID-3格式，或混合卡、双界面和非接卡。自动片张分拣工艺将良品和不良品分离开。不良片张通过设备软件设置可以轻松重做。



主要模块



自动片张输入



超声波绕线



光学质量检测与不良品标记



视觉检测不良芯片模块



热压芯片焊接



自动片张卸载



芯片模块冲切



非接测试



良品/不良品分拣



芯片模块放置



特点与技术参数

主要特点

- 一站式绕线与 RFID inlay 生产系统
- 自主完成天线设计与片张布局
- 轻松导入CAD数据
- 支持任何天线图形，包括弯曲图形
- 强大的设计软件可轻松创建新的天线布局
- 产品生产无需胶水，芯片临时固定采用真空吸附方式
- 电子光学测试，包括不良品标记
- 不良片张可以通过MTT的“重做模式”轻松重做
- 可以接入MB INCAPE

生产/工艺模块

- 自动片张放置精度 $\pm 0,1$ mm
- 带真空台的全自动片张输入
- 拾取与放置模块可以处理市面上任何尺寸的芯片
- 视觉检测到不良芯片直接剔除
- 气动传输系统保证天线顺利传输
- IC 模块可以采用上模和下模放置方式并且不需要在设备上进行大的改动
- 设备可用于单独的超声波绕线或结合非接芯片植入；植入与焊接的参数可调节控制；通过X和Y向的直线电机保证高精度和长使用寿命
- 热压焊接: 最多可配6个组合头，包括热压焊接和标准应用的断线感应
- 双界面卡生产最多可配8个超声波绕线头包括断线控制感应器
- 良率: 最大可达99.7%
- 真实的绕线精度: 小于 $\pm 0,05$ mm
- 真实的芯片放置精度: 小于 $\pm 0,05$ mm
- 真实的热压焊接精度: 小于 $\pm 0,01$ mm
(* 直线电机的真实精度是 ± 6 mm)

技术参数

- 材料: PETG, PVC, Polycarbonate, Teslin, 纸; 客户需求的其他材料
- 最大片张尺寸: 600 x 600 mm - 客户的其他需求
- 片张厚度: 0.1 – 0.3 mm (客户的其他需求)
- 绕线厚度: 0.08 – 0.12 mm
- 模块条带: 35 mm; 卷材直径最大. 330 mm
- 间隔带: 35 mm; 卷材直径最大. 330 mm
- 产能: 最高可达1800个非接inlay/时; 最高达2300个双界面 inlay/时; 取决于天线设计和材料



裱条带 ●

片张热烫印 ●

薄膜冲切 ●

INLAY 生产与测试 ●

片张装订 ●

片张层压 ●

冲卡 ●

卡片检测 ●

卡片热烫印 ●

ITH 540 & IT 50

INLAY 测试处理与 INLAY 测试系统

Inlay测试设备ITH 540 是一款对片张中转发器进行测试的半自动化设备。设备成熟、易于操作并可根据不同片张布局自由编程。RFID预层压片张、装订片张、层压片张和inlay片张的测试与预个人化得到大幅度简化。设备集成的ETS界面操作台符合人体工学设计，让操作和设备维护变得更为方便。设备易于维护和使用寿命长的特点进一步降低了运行成本。

IT 50手持式inlay测试设备适用于手动检测片张中转发器的功能。设备轻巧灵便，没有使用地点限制，因此可方便操作人员快速检测天线的好坏。设备上两个LED灯显示测试结果，绿灯指示良品，红灯指示不良品。设备随后可对不良天线进行标记从而保证所有进入下一生产流程的天线都是良品。



ITH 540



IT 50

主要模块



Y向片张台面



不良品标记



非接触测试站



特点与技术参数

主要特点

ITH 540

- 实现测试与预个人化
- 可灵活处理不同材料和片张布局
- 操作简单
- 自动不良品标记
- 合格/不合格天线自动计数

IT 50

- 手动 inlay测试设备
- 基于ATS (选择应答) 测试天线
- 按照客户需求根据ISO 14443 A 或 ISO 14443 B协议调整配置

生产/工艺模块

ITH 540

- Y-向片张台面
- 非接触测试站
- 不良品标记
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数


- 最大片张尺寸: 800 x 800 mm
- 片张厚度: 0.10 to 1.00 mm (客户的其他需求)
- 配置: 按照客户需求根据ISO 14443 A 或 B协议调整配置
- 产能: 最高达 1,000 片张/时; 取决于材料和测试参数以及操作速度

裱条带 

片张热烫印 

薄膜冲切 

INLAY 生产与测试 

片张装订 

片张层压 

冲卡 

卡片检测 

卡片热烫印 

UPH

500 750 1000 1250 1500 1750

ITH 550

自动 INLAY 测试处理

Inlay测试处理设备ITH 550是一台全自动片张转发器测试设备。设备稳定、易操作，可用于处理不同的片张布局。RFID预层压片张或成品片张的测试和预个人化得到

大幅度简化。设备集成ETS界面操作台，使操作和设备维护变更更方便。设备易于维护和使用寿命长的特点进一步降低了运行成本



主要模块



输入模块



不良品标记



非接触测试站



输出堆栈



视觉检测



特点与技术参数

主要特点

- 实现测试与预个人化
- 可灵活处理不同材料和片张布局
- 操作简单
- 自动不良品标记
- 合格/不合格天线自动计数

生产/工艺模块

- 输入堆栈与片张输入模块
- 自动片张传输
- 非接测试站
- 天线与全息图视觉检测 (选配)
- 不良品标记
- 输出堆栈与废料盒
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%


技术参数

- 最大片张尺寸: 650 x 650 mm
- 片张厚度: 0.20 to 0.80 mm (客户的其他需求)
- 配置: 按照客户需求根据ISO 14443 A 或 B协议调整配置
- 产能: 最高达 10,000 片张/时; 取决于材料和测试参数以及操作速度

裱条带 

片张热烫印 

薄膜冲切 

INLAY 生产与测试 

片张装订 

片张层压 

冲卡 

卡片检测 

卡片热烫印 

UPH



IAL 10000

INLAY 封装生产线

IAL 10000, 纽约的inlay封装生产线, 是纽约研发的第一台处理非层压片张的设备。IAL 10000支持ID-1和ID-3格式甚至客户定制的格式, 包含纽约新的图形界面确保方便的设备操作和维护。设备通过触摸式终端操作。inlay生产工艺包含天线生产、芯片放置和所有必须的电子

和/或视觉检测-包含不良品标记和将其放置到废料盒。紧接着装订片张, 不同膜层(数量、材料和厚度都可能不同)叠加后进行焊接装订。IAL 10000是高度模块化设备, 可根据单独的项目需求进行配置。



主要模块



薄膜输入



切割与冲切



胶水分发



芯片应用



绕线



焊接:芯片连接



电子测试



视觉检测



装订模块



未层压片张输出



特点与技术参数

主要特点

- 卷到张，张到张，卷到卷
- 完整的inlay封装（包括卡片/电子护照资料页材料装订）
- 按流程要求模块化配置
- 幅宽: 750 x 750 mm
- 设备多个模块可以使用视觉系统进行X, Y向的自动角度调节
- Inlay质量检测: 视觉检测和/或电子检测(ATS 或 RFM), 不良品标记打印, 不良品托盘

生产/工艺模块

- 卷轴释放原材料或输入堆栈输入片张材料
- 冲切参考孔和芯片槽；然后将卷材分切为张
- 胶水分发到芯片槽用于固定芯片
- 冲切前检测芯片电性能然后将其放置到芯片槽内（选配）
- 视觉系统用于检测不良芯片模块，条带位置和条带方向
- 超声波绕线系统绕制天线，每个绕线模块可配最多12个绕线头(选配: 2个绕线模块)
- 天线末端焊接到芯片上
- 光学检测系统和/或电性能检测系统检测产品质量，不良inlay会被打上标记然后传输到集成的盒子里
- 可手动重做不良inlay。(或者使用 MTT 2462)
- 输入与装订额外的补偿层
- 从上面和/或下面输入与装订额外的覆膜层

技术参数

- 片张尺寸: 190 x 190 mm, 最大 750 x 750 mm
- 基材材料: ABS, PC, PVC, PETG, Teslin, 客户需求的其他材料
- 设备配置: 标准4头，最多可配置24个头
- 天线类型: 非接式、双界面、线圈模块（感应耦合）、偶极子

裱条带

片张热烫印

薄膜冲切

INLAY 生产与测试

片张装订

片张层压

冲卡

卡片检测

卡片热烫印

UPH

8000 9000 10000 11000 12000 13000

SSC 2502 & SSC 2502/1

半自动片张装订系统

SSC 2502半自动装订系统是专门用来整合和预固定各塑料薄膜层，为后续层压工艺准备整体性片张原料的设备。设备灵活、功能多样、易于操作。在垂直可调节的框架上搭配了可旋转的操作台面和脚踏开关，任何操作人员都能轻松操控。设备配置可调节的边缘引导和附加的热焊接模块，适用于广泛的产品范围，包括非接触式芯料。

SSC 2502/1是整合和预固定各塑料薄膜层，为后续层压工艺准备整体性片张原料的手动操作设备。操作人员可以灵活调节设备高度和台面位置。按照边缘对齐手动排列各片层，并用超声波焊接模块手动地进行预固定。这可在完成整套预固定工艺的同时在不到1秒内设置随机数量的焊接点。在完成装订工艺后，由操作人员手动移除预固定的片张。



SSC 2502



SSC 2502/1

主要模块



超声波焊接模块
(SSC 2502/1)



热焊接模块
(SSC 2502)



可调节定位点



照明
(SSC 2502/1)



可旋转台面



参数控制
(SSC 2502)



特点与技术参数

主要特点

- 用于独立片张和安全特性层的半自动装订系统
- 适用于标准装订任务和安全应用需求
- 最小占用空间和简易操作
- 安装简单，易于维护
- 可接入MB INCAPE

生产/工艺模块

- 基于片张切边对齐校准
- 桌面可调节的定位器
- SSC 2502/1 – 手动超声波焊接模块
- SSC 2502 – 脚踏开关操作热焊接模块
- 焊接温度可调节
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%
- 环境条件:
 - 室温: 23°C; +/-3°C
 - 湿度: 50%; +/-10%

技术参数


- 片张材料: PVC, PC, ABS; 客户需求的其他材料
- 片张尺寸最小/最大: 290 x 290 mm / 800 x 800 mm
- 片张厚度最小/最大: 50 - 400 μ m
- 最大装订厚度: 最大 1 mm
- 最高焊接温度: 最高 450°C
- 产能: 最高达 100 张/时; 取决于材料和操作员

裱条带 

片张热烫印 

薄膜冲切 

INLAY 生产与测试 

片张装订 

片张层压 

冲卡 

卡片检测 

卡片热烫印 



SSC 200

半自动片张装订系统

SSC 200的设计理念简单而精巧。只需要一个操作员手动地将中心层放置在可调制制动器上，手动校准，设备就可以自动根据要求，将上下面材覆盖到芯料上，无所谓材料和厚度。

在完成裁切和输出前，通过2台超声波焊接系统将手动输入的中心片张和自动进料的覆盖面材牢固的固定在一起。SSC200由一台操作面板进行控制，里面存储了预设的生产配置文件。



主要模块



手动片张校准台面



参数控制



自动覆膜卷轴



裁切模块



超声波焊接模块



片张输出



特点与技术参数

主要特点

- 高产能的半自动装订系统
- 卷材自动进料和定位
- 自动传输和裁切系统
- 自动焊接参数控制
- 中心层片张依据边缘对齐，手动进料
- 安装简单，易于维护
- 可接入MB INCAPE

生产/工艺模块

- 内置覆膜卷轴系统
- 集成CLI/MLI片张的定位打孔装置(选配)
- 传感器控制面材边缘对齐或磁条对齐
- 2个可调节的超声波焊接模块
- 可调节的定位器
- UV光照系统用于安全特性检测(选配)
- 厚度测量系统防止片张重叠(选配)
- 焊接模块之后的裁切模块
- 传感器控制面材边缘或磁条位置对齐
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数


- 片张材料: PVC, PC, ABS
- 面材厚度: 40 – 300 μm
- 卷轴宽度: 最大 720 mm
- 卷轴直径/中心直径: 最大 750 mm / 76 mm
- 中心层最小/最大片张尺寸: 290 x 290 mm / 720 x 720 mm
- 中心层最小/最大片张厚度: 45 - 600 μm
- 校准精度: +/- 250 μm
- 产能: 最高达 400 张/时; 取决于材料和操作员

裱条带 

片张热烫印 

薄膜冲切 

INLAY 生产与测试 

片张装订 

片张层压 

冲卡 

卡片检测 

卡片热烫印 

UPH



SSC 2700

半自动片张装订系统

SSC 2700半自动装订系统是用来整合和预固定各塑料薄膜层，为后续层压工艺准备整体性片张的设备。SSC 2700是多用途，高精密，高精度的设备。内置的视觉系

统确保设备只能装订与印刷标记完全对齐的片张。额外的热焊接模块和视觉系统实现品种繁多的产品装订需求，包括含有非接触式芯料和/或磁条的片张。



主要模块



片张存储架



视觉检测



2个焊接模块



真空台



参数控制



特点与技术参数

主要特点

- 将片张层和安全特性层材料进行手动装订的系统
- 适用于标准装订任务和需要视觉控制定位的安全应用
- 通过高精度的视觉控制来校准片张
- 最小占用空间和简易的操作
- 每个片层参数都可独立编程控制(保证正确序列)
- 符合人体工程学的片张供应货架(选配)
- 可编程焊接位置、时间和温度
- 可编程最多7个不同的焊接位置
- 可接入MB INCAPE

生产/工艺模块

- 前/后印刷高精度片张视觉校准系统
- 印刷标记, 天线接触点, 安全特性或其他片张的可视特性都可用于对齐
- 集成CLI/MLI片张的定位打孔装置(选配)
- UV光照系统检测是否存在UV打印(选配)
- 厚度测量系统防止片张重叠(选配)
- 可配置多达3个独立的摄像头校准系统
- 2个顶部热焊接模块(可选配顶部或底部)
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数


- 片张材料: PVC, PC, ABS; 客户需求的其他材料
- 片张尺寸最小/最大: 290 x 290 mm / 750 x 750 mm
- 片张厚度最小/最大: 50 - 400 μm
- 最大装订厚度: 最大 1 mm
- 最高焊接温度: 最高 400°C
- 焊接时间/压力: 0 - 10 sec / 78 - 188 N
- 产能: 最高100 张/时; 取决于材料和操作员


裱条带 

片张热烫印 

薄膜冲切 

INLAY 生产与测试 

片张装订 

片张层压 

冲卡 

卡片检测 

卡片热烫印 



ASC 2900

全自动片张装订系统

ASC 2900是全自动，超灵活的片张装订设备。模块化的设计可装订片式的最多5层中心片张和卷式的2层面材。采用高精度光学定位校准处理，可以应用于非接触式、双界面和其他高端卡片，如ID卡或EMV卡。全自动的设

备产能达到每小时700张。尽管是全自动设备，仍然可以满足客户灵活的产品需求。不同物料间更换简便，最多可装订5层中心片张，满足了多样化产品配置。



主要模块



自动片张进料系统



自动面材进料系统



可移动控制面板



对齐印刷标记的视觉系统



超声波焊接



裁切模块



片张输出栈



ASC 2900

特点与技术参数

主要特点

- 全自动高速片张装订系统
- 卷式面材进料
- 高精度视觉校准系统
- 适用高端产品如防伪证件或非接卡的成熟方案
- 可依据印刷标记, 天线触点, 安全特性或者其他片张上独立的形状标志进行对齐编程
- 中心层张到张处理系统
- 经过整理和预固定后的片张输出堆栈系统
- 灵活独立配置的装订模块, 采用模块化设计(可以现场升级和扩展)
- 最多支持7层装订
- 可接入MB INCAPE

生产/工艺模块

- 卷轴系统支持2层卷式面材输入
- 用于磁条面材的持续边缘控制系统
- 超声波传感器可检测双张片材
- 裁切模块, 位于焊接模块之后
- 超声波焊接系统
- 视觉控制校准系统
- 厚度测量模块(选配)
- 集成CLI/MLI片张的定位打孔装置(选配)
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数

- 片张材料: PVC, PC, PET; 客户需求的其他材料
- 校准精度: $\pm 150 \mu\text{m}$
- 面材宽度: 最大 720 mm
- 卷轴直径: 最大 750 mm
- 片张尺寸最大: 720 x 720 mm
- 片张厚度: 面材 $\geq 50 \mu\text{m}$ / 中心层 $\geq 100 \mu\text{m}$
- 产能: 最高700 张/时; 取决于材料和布局

UPH



裱条带 ●

片张热烫印 ●

薄膜冲切 ●

INLAY 生产与测试 ●

片张装订 ●

片张层压 ●

冲卡 ●

卡片检测 ●

卡片热烫印 ●

ASC 3000

全自动片张装订系统

ASC 3000是全自动张到张装订系统，可根据片张尺寸或装订层数进行快速调节。根据客户需求，设备可配置左或右向传输装置。设备装订精度高，适用于非接式、双界面和其他高端卡，例如ID卡或EMV卡。这台全自动

化设备的产能最高可达1300套/时。不同物料间更换简便，最多可装订9层中心片张，满足客户多样化产品配置需求。



主要模块



自动片张进料系统



超声波焊接



边缘对齐



片张输出栈



特点与技术参数

主要特点

- 全自动高速片张装订系统
- 高精度边缘对齐
- 所有层均可张到张处理
- 右或左传输配置
- 进料与装订模块(最多可配置9个栈)
- 可接入MB INCAPE

生产/工艺模块

- 裁切后的片张放置在堆栈，由一个升降臂放置到隔离位置
- 吸盘和鼓风装置用于分离片张
- 双层片张与缺失片张控制
- 在X和Y方向的边缘对齐系统
- 超声波焊接机组
- 厚度测量模块(选配)
- 输出整合与预固定的片张到堆栈系统
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数

- 片张材料: PVC, PC, ABS, Teslin, 客户需求的其他材料
- 厚度: 100 – 400 μm
- 存料高度: 每个最大 450 mm
- 出料高度: 最大 600 mm
- 装订精度: $\pm 0,15$ mm
- 焊接工艺: 超声波
- 焊接时间: 最长5 秒
- 焊接点: 2 或 4 (选配)
- 产能: 最高1300 套/时; 取决于材料和布局

UPH



裱条带

片张热烫印

薄膜冲切

INLAY 生产与测试

片张装订

片张层压

冲卡

卡片检测

卡片热烫印

LP 5570

复杂卡片结构的片张层压系统

纽约的层压设备LP 5570适用于复杂结构卡片例如高防伪卡的制作。可用于层压预个人化片张、塑料卡、智能卡和非接卡。设备符合最新的经济可持续性发展需求，并拥有良好的产品质量与工艺流程。所有重要的工艺参数例如温度、压力和循环时间都可以通过软件持续和单独

控制。这些特点令设备能在最佳状态下层压所有现今市场上的卡片材料，如 ABS, PVC, PC, PET, PETG, PS, PE, 和 PP。用于热压的可选功能有重量补偿和抽真空，适用于复杂卡片的层压。LP 5570层压可以配置4、6或8开口，且都可以根据生产材料处理6到12层材料层压。



主要模块



自动装卸篮



半自动或全自动装卸台



层压



减压



可编程工艺参数



产品温度测量



抽真空



冷却模块



重量补偿



导热油加热



特点与技术参数

主要特点

- 自动全尺寸片张层压系统
- 适用于复杂卡结构如身份证和其他高防伪卡
- 单塔或双塔
- 全模块化设计
- 广泛可编程工艺参数
- 直观的人机界面确保简单有效的系统和操作流程
- 优化的能源管理系统有利于环境保护和节省成本
- 特别设计的加热盘用于精确和均匀的温度控制
- 可接入 INCAPE系统

生产/工艺模块

- 最多配置8个开口
- 抽真空系统(选配)
- 重量补偿系统(选配)
- 加热板平均加热温度偏差: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 总体加热板平均加热温度偏差: $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- 特殊的温度管理
- 可编程的循环时间、层压压力和温度
- 新产品参数教学/设置可在5分钟内完成
- 热压和冷压 (选配)
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数

- 片张材料: PVC, PC, ABS; 客户需求的其他材料
- 片张尺寸: 600 x 790 mm (客户需求的其他尺寸)
- 开口: 4, 6 或 8
- 层压压力: 50 – 1,250 kN
- 重复精度: $\pm 0.5\%$
- 温度偏差: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 表面光滑度: $\leq 1.2 \mu\text{m}$
- 产能: 最高144 (单塔) / 288 (双塔) 张/时;
取决于材料和布局



裱条带

片张热烫印

薄膜冲切

INLAY 生产与测试

片张装订

片张层压

冲卡

卡片检测

卡片热烫印

LP 5570/ecoLINE

PVC & PC高产能片张层压系统

纽约层压设备LP 5570/ecoLINE适用于PVC和PC高产能生产。可用于层压预个人化片张、证照资料页和类似产品如塑料卡、智能卡和非接卡。设备符合最新的经济可持续发展需求，并拥有良好的产品质量和工艺流程。所有重要的工艺参数例如温度、压力和循环时间都可以通过

软件持续和单独控制。这些特点令设备能在最佳状态下层压所有现今市场上的卡片材料，如 ABS, PVC PC, PET, PETG, PS, PE, 和PP。热压模块可选配重量补偿，适用于塑料卡片层压。LP 5570/ecoLINE可以配置8或10个开口，且都可以根据生产材料处理6到12层材料层压。



主要模块



自动装卸篮



半自动或全自动装卸台



层压



减压



可编程工艺参数



产品温度测量



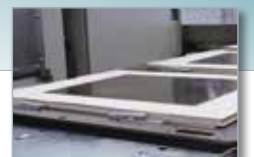
冷却模块



重量补偿



导热油加热



特点与技术参数

主要特点

- 自动全尺寸片张层压系统
- 双塔
- 高度精确的加热技术
- 适用于 PVC 量化生产
- PC 可广泛编程工艺参数
- 直观的人机界面确保简单有效的系统和操作流程
- 优化的能源管理系统有利于环境保护和节省成本
- 特别设计的加热盘用于精确和均匀的温度控制
- 模块化设计
- 可接入 INCAPE 系统

生产/工艺模块

- 8 或 10 个开口
- 重量补偿系统 (选配)
- 加热板平均加热温度偏差: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 总体加热板平均加热温度偏差: $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- 特殊的温度管理
- 可编程的循环时间、层压压力和温度
- 新产品参数教学/设置可在 5 分钟内完成
- 热压和冷压 (选配)
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数

- 片张材料: PVC, PC, ABS; 客户需求的其他材料
- 片张尺寸: 620 x 720 mm (客户需求的其他尺寸)
- 开口: 8 / 10
- 层压压力 / 热压: 25 – 630 kN
- 层压压力 / 冷压: 50 – 1,250 kN
- 重复精度: $\pm 0.5\%$
- 温度偏差: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 表面光滑度: $\leq 1.2 \mu\text{m}$
- 产能: 最高 350 张/时; 取决于材料和布局

UPH



裱条带

片张热烫印

薄膜冲切

INLAY 生产与测试

片张装订

片张层压

冲卡

卡片检测

卡片热烫印

CP 202

冲卡系统

纽约全自动冲卡系统CP 202是用于从片张中冲切塑料卡的设备。设备适合中高产能标准ID-1卡片生产。电动冲切系统能够通过定位标对齐保证持续冲切精度，且经验证，模具使用寿命长。可选择3列或4列冲切布局带来

更高的灵活性。优化的设备设计允许快速简单地更换产品。取决于配置和材料，设备产能最高可达16000张卡/时。



主要模块



片张输入



片张对齐



冲切模块



自动排废模块



卡闸卡片输出



特点与技术参数

主要特点

- 自动卡片冲切与片张输入
- 光学片张对齐和定位系统确保高精度冲切
- 自主模具生产保证模具使用寿命长
- 快速自主模具打磨服务
- 直观的用户界面，易于操作
- 占地面积小，适合有限的生产区域

生产/工艺模块

- 片张堆栈自动片张输入
- 电动冲切系统
- 冲切速度可调节
- 底部光学感应系统用于冲切位置的片张对齐和定位
- 3- / 4-列冲切工具
- 自动卡片堆栈系统使用标准纽约卡闸
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数


- 片张材料: PVC, ABS; 客户需求的其他材料
- 片张尺寸最小/最大.: 295 x 360 mm / 405 x 640 mm
- 片张厚度: 500 – 1,000 μm
- 冲切速度: 可编程, 最高 0.4 s / 循环
- 冲切工具: 3- / 4-列
- 产品尺寸: ID-1
- 冲切精度 (位置): $\pm 100 \mu\text{m}$
- 产能: 最高达16,000张卡/时, 布局4 x 8

裱条带 

片张热烫印 

薄膜冲切 

INLAY 生产与测试 

片张装订 

片张层压 

冲卡 

卡片检测 

卡片热烫印 

UPH

10000 15000 20000 25000 30000 35000

CP 2007/A - CP 2007/M

冲卡系统

纽约全自动和半自动冲卡系统CP 2007/A和CP 2007/M 适用于从片张中冲出塑料卡。设备适合标准材料ID-1格式卡片和特殊异型卡（取决于模具设计）的高质量高产能生产。强大的液压冲切系统通过定位标对齐保证持续冲

卡精度，且经验证，模具使用寿命长。设备可选择最高6列冲切布局带来高度灵活性，优化的设备设计允许快速简单地更换产品。取决于配置和材料，设备产能最高可达35000张卡/时。



CP 2007/A



CP 2007/M

主要模块



片张输入



片张裁切
(选配)



片张对齐



冲切模块



自动排废模块



卡闸卡片输出



特点与技术参数

主要特点

- 自动卡片冲切系统
- 手动/自动片张输入系统
- 光学片张对齐和定位系统确保高精度冲切
- 自主模具生产保证模具使用寿命长
- 特殊/定制的模具设计
- 快速自主模具打磨服务
- 可升级的模块化设计 – 现场升级到自动化系统
- 特殊形状模具（包括2步冲切和裁切）

生产/工艺模块

- CP 2007/M 手动片张输入
- CP 2007/A 从堆栈自动输入片张
- 液压驱动冲切系统 (直接驱动)
- 冲切速度可调节
- 上/下光学感应系统用于冲切位置的片张定位
- 1-到6-列冲切模具
- 自动卡片堆栈系统使用标准纽约卡闸
- 卡闸更换/缓冲器: CH 2007/3; CH 2007/B; CH 2007/LS 用于高度自动化生产和分拣
- 传送带用于特殊卡片传送（形状，尺寸和穿孔）
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数

- 片张材料: PVC, ABS, 纸; 客户需求的其他材料
- 片张尺寸最小/最大: 290 x 360 mm / 810 x 760 mm
- 片张厚度: 300 – 1,000 μm
- 冲切速度/压力: 可手动调节 / 30 kN
- 冲切模具: 1- 到 6-列用于 ID-1卡
- 产品尺寸: 最大 205 x 260 mm
- 冲切精度 (位置): +/- 150 μm
- 产能: 最高 35,000 张卡/时; 取决于材料和布局 (6-列模具)

裱条带 ●

片张热烫印 ●

薄膜冲切 ●

INLAY 生产与测试 ●

片张装订 ●

片张层压 ●

冲卡 ●

卡片检测 ●

卡片热烫印 ●

UPH

10000 15000 20000 25000 30000 35000

CP 2021/A - CP 2021/M

冲卡系统

纽约全自动和半自动冲卡系统CP 2021/A和CP 2021/M 适用于从片张中冲出智能卡。设备适合标准材料ID-1格式卡片高质量高产能生产，适用于广泛的卡片材料包括PC。强大的液压冲切系统通过定位标对齐保证持续冲卡

精度，且经验证，模具使用寿命长。设备可选择1-、2-、3-、4- 或5列冲切布局带来高度灵活性，优化的设备设计允许快速简单地更换产品。取决于配置和材料，设备产能最高可达31000张卡/时。



CP 2021/A



CP 2021/M

主要模块



片张输入



片张裁切
(选配)



片张对齐



冲切模块



自动排废模块



卡闸卡片输出



特点与技术参数

主要特点

- 高速度高精度的系统设计
- 光学片张对齐和定位系统确保高精度冲切
- 自主模具生产保证模具使用寿命长
- 特殊/定制的模具设计
- 快速自主模具打磨服务
- 可升级的模块化设计 – 现场升级到自动化系统
- 经市场验证成熟的PC卡冲卡系统

生产/工艺模块

- CP 2021/M 手动片张输入
- CP 2021/A 从堆栈自动输入片张
- 液压驱动冲切系统 (直接驱动)
- 冲切速度可调节
- 上/下光学感应系统用于冲切位置的片张定位
- 1-到5-列冲切模具用于ID-1卡片生产
- 自动卡片堆栈系统使用标准纽约卡闸
- 卡闸更换/缓冲器: CH 2021/3; CH 2021/B; CH 2021/LS
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数

- 片张材料: PVC, PC, ABS, 纸; 客户需求的其他材料
- 片张尺寸最小/最大.: 210 x 330 mm / 810 x 760 mm
- 片张厚度: 500 – 1,000 μm
- 冲切速度/压力: 25 – 200 mm / s / 100 kN (可编程)
- 冲切模具: 1- 到 5-列
- 产品尺寸: ID-1; 客户需求的其他尺寸
- 冲切精度: +/- 100 μm
- 产能: 最高达31,000 张卡/时; 取决于材料和布局 (5-列模具)

裱条带 ●

片张热烫印 ●

薄膜冲切 ●

INLAY 生产与测试 ●

片张装订 ●

片张层压 ●

冲卡 ●

卡片检测 ●

卡片热烫印 ●

UPH



CI 100

卡片检测系统

纽约的CI 100是经济型小型自动化卡片检测设备，适用于 ID-1 塑料卡的检测。基础设备可检测卡片一面的表面质量和印刷质量。设备可100%自动检测每一张卡片，产能最高可达5000张卡/时。可在卡片传输中检测卡片印刷

和表面的偏差。这台检测系统功能丰富，可根据客户需求配置如双面印刷检测和表面检测，额外的单面检测站如UV或微缩文字检测。



主要模块



卡片输入卡闸



清洁模块



卡片翻转



坏卡分拣



印刷检测



表面检测



卡片输出卡闸



特点与技术参数

主要特点

- 自动卡片检测系统
- 广泛的光学检测参数
- 印刷检测和表面独立的光学检测系统
- 通过软件看到每个独立的检测站
- 统计与报告; 计数与分拣
- 定制的扩展的统计功能 (选配)
- 定制的检测程序开发
- 参照样卡的先进学习模式 (黄金模板)
- 可接入纽约INCAPE

生产/工艺模块

- 具有卡片自动分离功能的卡闸输入卡片
- 表面与印刷检测系统用于卡片正面检测, 反面检测系统(选配)
- 检测特征 (选配)
- UV 检测
- 微缩文字检测
- 卡闸输出更换器
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数

- 卡片材料: PVC, PC, ABS; 客户需求的其他材料
- 卡片尺寸/厚度: ID-1 / 350 – 1,000 μm
- 印刷检测分辨率: 75 μm / Pixel
- 表面检测分辨率: 75 μm / Pixel
- 表面检测光学系统: 灰度矩阵式摄像头
- 印刷检测光学系统: 彩色矩阵式摄像头
- 产能: 最高达5,000张卡/时; 取决于工艺参数



裱条带

片张热烫印

薄膜冲切

INLAY 生产与测试

片张装订

片张层压

冲卡

卡片检测

卡片热烫印

CI 200

CARD INSPECTION SYSTEM

CI 200是经济型小型自动化卡片检测设备，适用于ID-1 塑料卡的检测。基础设备可检测卡片一面的表面质量和印刷质量。设备可100%自动检测每一张卡片，产能最高可达20000张卡/时。可在卡片传输中检测卡片印刷和表面

的偏差。这台检测系统功能丰富，可根据客户需求配置如双面印刷检测和表面检测，额外的单面检测站如UV或微缩文字检测。另外，设备可配置2槽，4槽或6槽自由定义的输出分选盒。



主要模块



卡片输入



清洁模块



卡片翻转



卡片分拣



印刷检测



表面检测



输出盒



特点与技术参数

主要特点

- 自动卡片检测系统
- 卡片堆栈输入卡片/卡片输出到多个传送带
- 广泛的光学检测参数
- 印刷检测和表面独立的光学检测系统
- 通过软件看到每个独立的检测站
- 统计与报告; 计数与分拣
- 定制的扩展的统计功能 (选配)
- 定制的检测程序开发
- 参照样卡的先进学习模式 (黄金模板)
- 可接入纽约INCAPE

生产/工艺模块

- 具有卡片自动分离功能的卡片输入堆栈
- 表面与印刷检测系统用于卡片正面检测, 反面检测系统(选配)
- 检测特征 (选配)
- UV 检测
- 微缩文字检测
- 分拣系统4-或 6-槽 (选配)
- 卡片输入和输出卡闸 (选配)
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数

- 卡片材料: PVC, PC, ABS; 客户需求的其他材料
- 卡片尺寸/厚度: ID-1 / 350 – 1,000 μm
- 印刷检测分辨率: 75 μm / Pixel
- 表面检测分辨率: 75 μm / Pixel
- 表面检测光学系统: 灰度矩阵式摄像头
- 印刷检测光学系统: 彩色矩阵式摄像头
- 产能: 最高达20,000张卡/时; 取决于工艺参数



裱条带

片张热烫印

薄膜冲切

INLAY 生产与测试

片张装订

片张层压

冲卡

卡片检测

卡片热烫印

CI 36050

卡片检测系统

纽约CI 36050是全自动高速ID-1塑料卡检测系统。基础设备可检测卡片一面的表面质量和印刷质量。设备可100%自动检测每一张卡片，产能最高可达36000张卡/时，可满足几乎所有的检测应用。设备可在卡片传输中检测卡片印刷和表面的偏差。这台检测系统功能丰富，可根据

客户需求配置如双面印刷检测和表面检测，并可配置最多3个额外的单面检测站如UV、微缩文字、全息标、覆膜卡或透明卡检测。另外，设备可配置2槽，4槽或6槽自由定义的输出分选盒。



主要模块



卡片输入



清洁模块



卡片翻转



卡片分拣



印刷检测



表面检测



输出盒



特点与技术参数

主要特点

- 自动卡片检测系统
- 广泛的光学检测参数
- 印刷检测和表面检测精确的光学检测系统
- 通过软件看到每个独立的检测站
- 统计与报告; 计数与分拣
- 定制的扩展的统计功能 (选配)
- 定制的检测程序开发
- 参照样卡的先进学习模式 (黄金模板)
- 可接入纽约INCAPE

生产/工艺模块

- 具有卡片自动分离功能的卡片输入堆栈
- 表面与印刷检测系统用于卡片正面检测, 反面检测系统(选配)
- 可选检测特征
 - » UV / 微缩文字
 - » DOVID 全息标检测
 - » 覆膜卡检测 (高反光)
 - » 透明卡检测
 - » 定制的检测特征
- 分拣系统4-或 6-槽 (选配)
- 自动教学功能
- 卡片输入和输出卡闸 (选配)
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%

技术参数

- 卡片材料: PVC, PC, ABS; 客户需求的其他材料
- 卡片尺寸/厚度: ID-1 / 350 - 1,000 μm
- 印刷检测分辨率: 75 μm / pixel
- 表面检测分辨率: 75 μm / pixel
- 表面检测光学系统: 灰度矩阵式摄像头
- 印刷检测光学系统: 彩色矩阵式摄像头
- 产能: 36,000 张卡/时

UPH



裱条带

片张热烫印

薄膜冲切

INLAY 生产与测试

片张装订

片张层压

冲卡

卡片检测

卡片热烫印

CHS 6001

卡片热烫印系统

纽约CHS 6001可轻松集成到任何现有的生产环境中。通过2个烫印模块，可在卡片的正反面上烫印安全膜层例如全息标，签名条和/或其他防伪特征。设备带有卡片翻转功能，因此可以一次性完成卡片两面烫印。这样带

2个烫印头的CHS 6001可达到市场最优成本。设备成熟的热烫印方案可用于广泛的标准应用和特殊应用。配备卡闸缓冲系统，设备产能最大可达5500张卡/时，适合高产能生产任务。



主要模块



卡闸卡片输入



测试站
(卡片方向, 输入厚度测量)



热烫印
(位置1)



卡片翻转



热烫印
(位置2 - 选配)



卡片输出



废卡箱



特点与技术参数

主要特点

- 用于全息图、签名条、刮刮条、阴阳文字等的自动卡片热烫印系统
- 快速更换模具
- 卡片正面/反面烫印
- 烫印位置可调节
- 100 % 在线质量检测
- 自主模具生产与定制
- 高精度烫印定位系统
- 人性化操作和先进的学习模式
- 可接入纽豹INCAPE

生产/工艺模块

- 从卡闸到卡闸的自动卡片输入/堆栈
- 烫印位置在x/y 向可调节
- 烫印压力可调节
- 烫印温度可编程
- 卡片翻转模块 (选配)
- 一个热烫印模块, 可按需求扩展到2个
- 在线质量检测的视觉系统 (选配)
- 卡闸缓冲提高自动化生产时间 (选配)
- 可用率: 最高达 95%
- 良率: 最高达 99.7%
- 环境调节: 室温: 23°C; +/-3°C; 湿度: 50%; +/-10%

技术参数

- 卡片格式/材料: ID-1 / PVC, PC, ABS; 客户需求的其他材料
- 覆膜规格
- 卷轴内直径: 1", 3"
- 卷轴最大外直径: 200 mm
- 宽度: 10 – 85 mm
- 全息定位: 可调间距或印刷定位标
- 烫印温度: 最高 230 °C; 可编程
- 烫印压力: 手动调节
- 标准烫印: MiniVisa; Visa; MasterCard; 签名条, 客户需求的其他形状
- 产能: 最高达 5,500 张卡/时; 取决于材料和流程

UPH



裱条带 ●

片张热烫印 ●

薄膜冲切 ●

INLAY 生产与测试 ●

片张装订 ●

片张层压 ●

冲卡 ●

卡片检测 ●

卡片热烫印 ●

质量检测

检测设备

卡片检测设备



CSG 100 / 200
卡片尺寸测量



CTG 100 / 200
卡片厚度/芯片槽深度测量



DLT 500
剥离力测量

智能卡检测设备



SCF 2300
弯曲度测试



TWT 2500
三向转动测试



SCT 2400
扭力测试



MAT 1230
模块粘附测试

卡片个人化检测设备



测量显微镜
凸字间距测量



色彩密度测量
色彩密度测量



UV-光照柜
多种印刷工艺检测



产品系列

您的一站式技术合作伙伴

AUTOMATION

卡与护照

- IC 模块生产
- 卡片与智能卡生产
- 护照持证入页与护照册生产
- 卡与电子护照个人化
- 包装与邮封

RFID / 电子标签

- 天线生产 & Inlay 封装
- 复合
- 个人化

半导体后道

- IC 模块生产
- 载带生产
- 芯片分选

工业检测系统

- 包装
- 金属件处理
- 特殊检测方案

未来技术

- 聚光太阳能技术
- 柔性太阳能电池技术
- 太阳能电池板技术
- eSIM 个人化
- LED 技术

TECURITY®

- 身份证解决方案
- 电子护照解决方案
- MB IDVERSO® 出入境管理解决方案
- 驾照与车辆登记证解决方案
- 生产设施

精密零件与系统

- 精密零件
- 表面处理工程

咨询

- 识别客户需求
- 规划与设计
- 项目实施
- 日常运作

服务

- 全球性的服务与支持办公点
- 全球性零部件供应
- 签订快速反馈与全面服务合同
- 服务与维护管理
- 更新与升级
- 电话服务、远程支持与热线电话 (24小时)
- 不同级别的培训与支持
- 生产与管理支持

本手册内容可不经通知随时更改。我们不保证手册内容的准确性、完整性和及时性。
纽约集团不作任何形式的明示或默示保证，不对错误或遗漏承担任何责任。
任何设备系统信息只有在以正式报价和/或正式技术数据表形式提供时才具有约束力。

笔记







MÜHLBAUER GERMANY

Mühlbauer Group Headquarters
Josef-Mühlbauer-Platz 1, 93426 Roding, Germany
Phone: +49 9461 952 0, Fax: +49 9461 952 1101
info@muehlbauer.de, www.muehlbauer.de

MÜHLBAUER USA

Mühlbauer Inc.
226 Pickett's Line
Newport News, VA 23603-1366, USA
Phone: +1 757 947 2820, Fax: +1 757 947 2930
info@muhlbauer.com, www.muhlbauer.com

MÜHLBAUER MALAYSIA

Muehlbauer Technologies Sdn. Bhd.
No. 3 Jalan TU 62, Taman Tasik Utama,
75450 Melaka, Malaysia
Phone: +60 6 2517 100, Fax: +60 6 2517 101
info@muehlbauer.com.my, www.muehlbauer.com.my

MÜHLBAUER SERBIA

Mühlbauer Technologies d.o.o.
Evropska 17, 22300 Stara Pazova, Serbia
Phone: +381 22 215 5100, Fax: +381 22 215 5130
serbia@muehlbauer.de, www.muehlbauer.de

纽约中国

纽约智能识别技术（无锡）有限公司
中国江苏省无锡市新区华谊路23号
邮编：214135
电话：+86 510 8190 0100, 传真：+86 510 8190 0101
info@muehlbauer.cn, www.muehlbauer.cn

MÜHLBAUER SLOVAKIA

Muehlbauer Technologies s.r.o.
Novozámocká 233, 94905 Nitra, Slovakia
Phone: +421 37 6946 000, Fax: +421 37 6946 501
info@muhlbauer.sk, www.muhlbauer.com



MÜHLBAUER GMBH & CO. KG

Josef-Mühlbauer-Platz 1 | 93426 Roding | Germany
Tel.: +49 9461 952 0 | Fax: +49 9461 952 1101
Mail: info@muehlbauer.de | Web: www.muehlbauer.de